

# 国产替代迎来“窗口期”



■ 廖木兴/图

未来  
走势

## 2026年是拐点？ 别抱幻想

市场最关心的是：价格何时降温？答案可能令人失望。

供需模型显示，2026年上半年新增晶圆产能有限。三星平泽P3工厂、海力士清州M15X工厂的DRAM新产能要到2026年Q4才能释放，且主要用于HBM。SK海力士在与英伟达的第六代HBM供应谈判中，成功将价格提升逾50%，进一步增强其转移产能的动力。戴晓瑜认为，北美这一轮数据中心需求爆发带来的订单，预估会持续到2026年年底，这也意味着，如果原厂没有扩产计划，产能的紧张至少持续到明年年底。

一位三星半导体中国区的前高管向记者分析：“外界都在骂我们涨价太狠，但站在原厂角度，这是理性的商业决策。HBM的利润率是DDR4的三到四倍，而且订单已经排到2026年年底。现在不转型，等2027年HBM产能过剩了，再想回头做DDR4，市场可能已经被中国厂商占领了。所以宁可放弃短期市场份额，也要抢占长期技术制高点。”

更深层的变化是，PC、手机的平均售价(ASP)进入“结构性上涨”新常态。AI PC普及要求16GB内存起步，32GB成主流；AI手机需要12GB+512GB组合。内存成本占比从过去8%升至18%-20%，整机价格中枢上移不可避免。惠普CEO恩里克·洛雷斯在财报会上表示，内存成本持续飙升最终将迫使公司上调产品价格，并推出低配置版本。这意味着，未来消费者可能面临“花更多的钱，买到更少配置”的尴尬局面。

对消费者而言，何时装机最划算？有数码圈人士认为，至少2026年春节装机额外多支付30%-50%溢价，非刚需可继续观望至2026年Q2。但也要警惕主板、显卡等其他配件价格跟涨带来的整体成本增加。“等等党”可能等到2026年Q3后的下行周期，但DDR4内存因产能持续收缩，价格回落难度较大。SSD因AI服务器需求刚性，回调空间有限。刚需用户可关注电商平台大促，或选择国产模组厂产品，性价比相对更高。

国产  
替代

## “三年战略窗口”乍现，但良率仍是坎

在此轮全球性缺货涨价潮中，国产存储产业链的动向备受关注。

半导体存储市场本有每隔3-4年的周期性波动。但AI需求的加入，使本轮周期的持续时间、强度和逻辑发生了根本变化。涨价潮让国产存储大厂迎来“三年战略窗口”。

一方面，国内存储大厂如长鑫存储(DRAM)和长江存储(NAND)正面临追赶先进制程与应对市场机遇的双重挑战。长鑫存储跟随全球巨头步伐，计划停止DDR4生产，将资源转向更先进的DDR5等技术。长鑫存储2025年Q3 DRAM月产能达7万片(12英寸晶圆)，规划2026年扩至15万片，仍不足全球5%，但已可覆盖国内PC、手机中低端需求。长江存储128层3D NAND月产能8万片，企业级SSD已通过华为、浪潮、曙光等服务器厂商验证，开始小批量供货。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛表示，在全球供应链重构的背景下，国产存储企业凭借成本优势和快速响应能力，正逐步打破海外巨头的垄断格局。数据显示，国产DRAM的市场份额已从2023年的不足5%提升至2025年的12%，预计2026年将突破15%；NAND Flash的国产替代率也在稳步提升。

但国产厂也面临“幸福的烦恼”——设备、材料仍受制于人。ASML DUV光刻机交付周期已拉长至18个月，更先进的EUV设备仍受美国出口管制；日本东京电子、美国泛林集团的刻蚀、薄膜沉积设备同样供应紧张。材料端，JSR、信越化学的光刻胶，德国默克的ALD前驱体，国产化率不足30%，品质和稳定性仍有差距。“设备进不来，产能就爬不上去。”某存储设备代理公司销售总监坦言，长鑫扩产计划比预期慢

3-6个月，部分设备到货后调试周期长达一年。

良率是另一道坎。国产DDR5颗粒良率目前约65%，而三星已超85%，成本差距明显。HBM更是“金字塔尖”，叠层封装、TSV硅通孔、散热等技术难度极高，国内尚无量产线，2027年前难打破三巨头垄断。“窗口期最多三年。”芯谋研究首席分析师顾文军提醒，若国产厂不能趁涨价周期把良率拉到80%以上、把客户固化成长期订单，一旦海外巨头扩产完毕，“又要被压回低端”。

长鑫存储的一位工程师在接受采访时也坦承：“其实我们压力很大。外面看着涨价很风光，但内部良率爬坡很痛苦。一片晶圆出来，要是良率只有60%，意味着40%的成本直接打水漂。三星能做到85%良率，他们的成本优势是碾压性的。我们现在是‘赔本赚吆喝’，主要是为了抢占市场份额和客户信任。”

另一方面，下游的模组厂商如江波龙、佰维存储、德明利等，则凭借一定的库存优势和灵活的市场策略，在2025年第三季度业绩大幅增长。2025年Q3，江波龙营收同比增长54.6%至65.39亿元，归母净利润暴增1994%至6.98亿元；佰维存储营收增68%至26.63亿元，净利润增564%至2.56亿元；德明利营收增79%至25.5亿元，净利润增167%至0.91亿元。三者存货金额分别达85亿元、57亿元、59亿元，较年初增长30%以上。

然而，其后续发展仍高度依赖于能否从原厂获得稳定的晶圆配额。“晶圆不是想囤就囤，而是拿着销售情况去求原厂多给配额。”江波龙董秘办人士透露，公司与长鑫、长江存储签了年度框架协议，价格随行就市，但配额有保障。这种“绑定国产”策略，在三星、海力士供应紧张时，反而成为竞争优势。

观察

## 价值链重构的深层冲击

这场看似由AI需求引爆的涨价，实质是全球半导体价值链的一次“权力再分配”：利润从下游整机回流上游晶圆，三星、海力士、美光毛利率普遍回升至40%以上，而联想、戴尔、惠普毛利率仅5%-8%，产业链利润分配严重失衡。

商业客户取代个人消费者成为价格接受者，PC、手机行业“低价竞争”逻辑被打破，企业级市场的刚性需求为涨价提供“缓冲垫”，个人消费者则进入“存量忍耐期”。国产替代获得三年“喘息窗”，长鑫、长江存储在战略窗口期加速扩产、提升良率，但设备、材料、技术仍是“卡脖子”，能否趁势突围仍是未知数。

消费者进入“存量忍耐期”，换机周期从24个月拉长至30个月以上，倒逼厂商从“堆配置”转向“云+端”协同创新，如“云内存”“云存储”等压缩成本方案。烈火炼真金，涨价潮终将退去，但留给中国存储产业的课题不会消失：如何把短期“价差”转化为长期“价差能力”，在下一轮下行周期到来前，把技术、产能、客户牢牢攥在自己手里。

因此，这场由AI引发的存储风暴，正在深刻重塑消费电子行业的成本结构、产品策略和竞争格局。它迫使PC厂商从“以量取胜”转向“利润优先”，推动手机品牌重新审视产品组合，也考验着整个供应链的韧性和应变能力。最终，所有调整的成本，都将在未来一段时间内，由每一位购买电子产品的消费者共同分担。行业的阵痛期，或许才刚刚开始。